

Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette: einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen Rapid Prototyping-Service anbieten: S / S in 24 Stunden, 4-8 Einheiten in 48-96 Produktionsstunden.

MINDESTKUPFERPLATTENLÖCHER .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER KÖNNEN NICHT VERBUNDEN WERDEN

Verpackt mit klarem, blasenlosem Film, 25 Stück / Beutel, legen Sie das Trockenmittel auf die Seite und legen Sie den Feuchtigkeitsindikator darauf

KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Dickschicht-Leiterplattenhersteller](#)

Produktbeschreibung

- [Lieferant von Keramik-Leiterplatten](#)

PCB P / N.	Q503701-A
Schichten zählen	2L
Material	B.ASE Keramik
Der Aufsichtsrat	0,55 mm
Kupfer thk	1/1 oz
Kleinste Lochgröße	1.6mm
Anzahl der Löcher (Stücke)	4
Linie w / s	/.
Impedanzprüfung S / N (Tol%)	N.
Oberflächenfinish	Elektrisches Silber
Siebdruckschweißmaske	Grün
Einfache Abmessungen	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50
Panelisierung	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50; UPS Nr.: 1
Besonderheit: abziehbare Maske	N.
Routing / Stanzen	CNC

•



www.o-leading.com

Aluminiumoxid Keramiks substrat PCB China

Unser Team





Zertifizierungen



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
 Certificate No: 16118Q10347R05

We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED
 Credit No: 61691591-000-07-17-2
 Registration Add: ROOM 603D 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING,31 TONKIN ST,CHEUNG SHA WAN,KL, HK
 Business Add: 1313 Floor 13 Fortune Building, Danstui Town Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**
 Which fulfills the requirements of the following standards
 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
 Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018
 This certificate is valid during: February 27, 2018 -- February 26, 2021
 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	----------------	------------------------------	----------------

The certification registration scope does't include those products/services scopes which fail to be covered by the relevant effective administrative permission and qualification permission required by the state. The effectiveness of this certificate shall be evaluated by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit conclusion. The related information of this certification can be searched at the public website of company www.cicc.com.cn.

201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component

UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [UL Product Databases](#).
 Click on a product designation for complete information.
[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED E490354
 Fortune Building, Nanheng West Road
 Room 1313
 Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Type	Cond Width			SS/ DS/ Diam	Area	Solder		Diper		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Min	Max				
Hub/Bayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	130	V-0	NI	-	-
Hub/Bayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) 31(1.25)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	-	-
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	-

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
 Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

http://www.ul.com/ulProductDatabase/PrintPage.aspx?ProductID=ZPMV2.E490354&ProductType=Wiring,Printed-Component&Page=10



Test Report No. CANEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
 SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new online platform for the collection of test results. The platform is available at [www.sgslab.com](#). The platform is designed to provide a secure and efficient way for clients to upload their test results. The platform is available in English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish, and Chinese. For more information, please contact your local SGS office or visit [www.sgslab.com](#).

Member of the SGS Group (SGS SA)

Verpackung & Lieferung

Verpackung Einzelheiten	Professioneller Hersteller von Leiterplatten seit 16 Jahren
Lieferdetail	7-12 Tage



FAQ

1. Wie garantiert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgenden erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. modernste Testwerkzeuge und Werkzeuge. Zum Beispiel. Fliegende Sonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (Schaltungstest).
4. Qualitätssicherungsteam, das mit dem Fehlerfallanalyseprozess spezifiziert wurde
5. Personalschulung und kontinuierliche Weiterbildung

2. Wie hält O-Leading den wettbewerbsfähigen Preis aufrecht?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Die chinesische Währung RMB legte gegenüber dem US-Dollar um 31% zu; Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat unsere Preise jedoch konstant gehalten. Es geht um unsere Innovationen, um Kosten zu senken, Abfall zu vermeiden und die Effizienz zu verbessern. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen mit unseren Kunden. Unsere

Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Karten kann der O-Leading-Prozess herstellen?

FR4-Platten mit hohem TG und hohem Halogengehalt, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist besser, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Schnittmaterial → innerer Trockenfilm → Innengravur → Innen-AOI → Mehrfachbindung → überlappende Pressschichten → Bohren → PTH → Beschichtung → Außen-Trockenfilm → Beschichtung → Außengravur → AOI → Außenschweißmaske → Nachnahmekomponente → Endbearbeitungsfläche → Fräsen → E / T → Sichtprüfung.